

10/566678

14P20P33P67770 01 FEB 2006

**Amendments under PCT Article 34  
in the Japanese Language**

IAP20 Rec'd PCT/PTO 01 FEB 2006

板に部品高さが高い電子部品を実装したときにも、ラベル等を貼るための凹部を形成しつつカバーの強度を確保できるP Cカードを実現することを目的とする。

- 本発明は、電子部品が実装されたプリント基板と、前記プリント
- 5 基板を収納する主としてフレーム材と平板部からなる本体カバーと、前記本体カバーに固定してプリント基板を蓋うカバー体と、前記電子部品との干渉を回避すべく前記電子部品と対向する前記本体カバーの平板部の部分に形成された1つ以上の孔部と、本体カバーの前記孔部を塞ぎ、本体カバーの平板部の一部分を覆うように固定可能な1つ以上の板状部材とを具備し、前記本体カバーの平板部の所
- 10 定範囲内に前記孔部を集中して形成すると共に、前記所定の範囲外においては凹部を形成し、前記板状部材の外側表面と前記本体カバーの外側表面とをほぼ同じ高さになるように構成すると共に前記板状部材の厚さを本体カバーの平板部の厚さよりも薄くなるように
- 15 構成したものである。

- 本発明のP Cカードは、部品高さの高い電子部品に対向するカバーの表面部分は孔部が形成され、その孔部をカバーの厚みよりも薄い板状部材で塞いでいるために、カバーの厚みを厚くして強度を
- 20 上げることができるとともに、より高さのある電子部品をプリント基板上に実装することができ、信頼性高いP Cカードが実現できることになる。

- また、本発明は本体カバーの所定の範囲内に孔部を集中して形成すると共に、孔部以外の範囲においてはカバーの外側に凹部を形成したことにより、電子部品と干渉しない部分のカバー体及び本体カ
- 25 バー表面は凹部を形成できるので、ラベルやメモ等を貼るスペース

を実現できるという効果がある。

図面の簡単な説明

## 請 求 の 範 囲

1. (補正後) 電子部品が実装されたプリント基板と、  
前記プリント基板を収納する主としてフレーム材と平板部からなる本体カバーと、
- 5 前記本体カバーに固定してプリント基板を蓋うカバー体と、  
前記電子部品との干渉を回避すべく前記電子部品と対向する前記本体カバーの平板部の部分に形成された1つ以上の孔部と、  
本体カバーの前記孔部を塞ぎ、本体カバーの平板部の一部分を覆うように固定可能な1つ以上の板状部材とを具備し、
- 10 前記本体カバーの平板部の所定範囲内に前記孔部を集中して形成すると共に、前記所定の範囲外においては凹部を形成し、  
前記板状部材の外側表面と前記本体カバーの外側表面とをほぼ同じ高さになるように構成すると共に前記板状部材の厚さを本体カバーの平板部の厚さよりも薄くなるように構成したP Cカード。
- 15 2. 本体カバーに被せる前記カバー体に、電子部品との干渉を回避する孔部を形成し、この孔部を板状部材で塞ぐ請求項1記載のP Cカード。  
3. 前記孔部周囲の本体カバー及びカバー体の外面に前記板状部材の厚さにほぼ等しい深さの段部を形成した請求項1又は2記載の
- 20 P Cカード。  
4. 前記本体カバーの平板部及びカバー体に形成した2つ以上の前記孔部を1つの前記板状部材で塞ぐように構成した請求項1又は2記載のP Cカード。  
5. (補正後) カバー体の所定範囲内に前記孔部を集中して形成
- 25 することを特徴とする請求項1記載のP Cカード。  
6. (補正後) 前記プリント基板の長手方向の一端に信号の伝達

が可能なコネクタを実装し、前記所定の範囲とは前記コネクタから  
所定の距離

内とする請求項 1 又は 5 記載の P C カード。